

证券代码：002815

证券简称：崇达技术



崇达技术股份有限公司

Suntak Technology Co., Ltd.

(深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207)

2022 年度非公开发行股票预案

二〇二二年一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行股票相关事项已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

二、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	365,065.83	200,000.00

三、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

四、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发行通过竞价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

五、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2021 年 9 月 30 日的总股本 875,638,601 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 262,691,580 股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东

大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。

六、本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

七、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。

八、公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

九、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况、公司未来三年股东回报规划等，详见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定、执行情况 & 未来股东回报规划”。

十、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定填补本次非公开发行后被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明”。同时，公司提示投资者关注本预案中公司对主要财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

释 义.....	7
第一节 本次非公开发行股票方案概要	9
一、发行人基本情况.....	9
二、本次非公开发行的背景和目的.....	9
三、本次发行对象及其与公司的关系.....	14
四、本次非公开发行股票方案概要.....	14
五、本次发行是否构成关联交易.....	16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	17
七、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件.....	17
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	18
一、本次募集资金使用计划.....	18
二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析.....	18
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	22
四、本次募集资金运用的可行性结论.....	23
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	24
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况.....	24
二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况.....	25
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	25
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	26
五、本次发行对公司负债结构的影响.....	26
六、本次发行相关的风险说明.....	26
第四节 公司利润分配政策的制定、执行情况 及未来股东回报规划	31
一、公司的利润分配政策.....	31

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况.....	34
三、公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划.....	35
第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	40
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算.....	40
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示.....	42
三、本次非公开发行的必要性和合理性.....	43
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.....	43
五、公司填补本次非公开发行即期回报摊薄的具体措施.....	44
六、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺.....	46
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.....	47

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般名词释义		
公司、本公司、发行人、上市公司、崇达技术	指	崇达技术股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	崇达技术股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票的行为
预案、本预案	指	崇达技术股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案
珠海崇达	指	珠海崇达电路技术有限公司，公司之全资子公司
最近三年及一期、报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
最近三年	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年度
股东大会	指	崇达技术股份有限公司股东大会
董事会	指	崇达技术股份有限公司董事会
监事会	指	崇达技术股份有限公司监事会
公司章程	指	崇达技术股份有限公司现行有效的公司章程
控股股东	指	姜雪飞先生
实际控制人	指	姜雪飞先生、朱雪花女士
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语释义		
印制电路板/线路板/PCB	指	Printed Circuit Board，在绝缘基材上按预定设计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板
双面板	指	绝缘基板的两面都有导电图形的 PCB
多层板	指	有四层及以上的导电图形的 PCB，层数通常为偶数
高层板	指	8 层及 8 层以上的 PCB
刚性板	指	以刚性基材制成的，具有一定强韧度的印制电路板
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性
柔性板、挠性板、FPC	指	利用挠性基材制成，并具有一定弯曲性的印制电路板

HDI 板	指	High Density Interconnection, 高密度互连板, 针对 PCB 线路互连密度高而言。通常指线宽/线距 0.1mm 以下, 小导通孔孔径 0.15mm 以下, 含有盲孔和埋孔的多层板
覆铜板、铜板	指	一种将增强材料, 浸以树脂胶黏剂, 覆上铜箔在热压机中经高温高压成形加工而制成的板材, 为 PCB 的主要基材
半固化片	指	一种主要由树脂和增强材料组成, 将增强材料浸以树脂, 经过烘干、裁剪后形成的制作覆铜板的坯料
5G	指	5th-Generation, 即第五代移动通信技术
CPCA	指	China Printed Circuit Association, 中国电子电路行业协会
Prismark	指	一家从事 PCB 行业统计与分析的国际机构
JEITA	指	日本电子信息技术产业协会

除特别说明外, 所有数值保留两位小数。若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称（中文）	崇达技术股份有限公司
公司名称（英文）	Suntak Technology Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	崇达技术
股票代码	002815
成立日期	1995年5月4日
法定代表人	姜雪飞
注册资本	875,638,520元
注册地址	深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A3栋C单元207
办公地址	深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号
联系电话	0755-26055208
传真号码	0755-26068695
电子信箱	zqb@suntakpcb.com
经营范围	双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板的生产（由分支机构经营）和销售；国内贸易，货物及技术进出口业务（按深贸管登证字第2003-703号办理）；线路板研发和技术咨询；信息技术咨询；设计咨询；企业管理咨询；机器设备租赁（不含融资租赁及其他限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

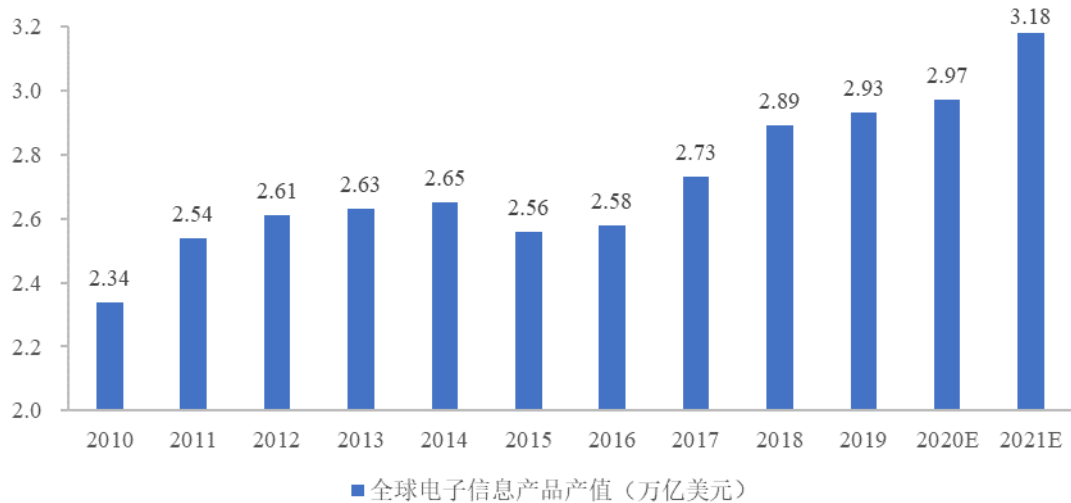
二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、全球电子产业蓬勃发展驱动 PCB 市场需求攀升

作为 PCB 行业的下游，电子产业的发展是决定 PCB 行业发展的基础，全球电子信息产业的长足进步和下游应用领域的不断深化推动 PCB 行业向前发展。根据 JEITA 预测，2021 年全球电子信息产品产值将达到 3.18 万亿美元，首次突破 3 万亿美元。

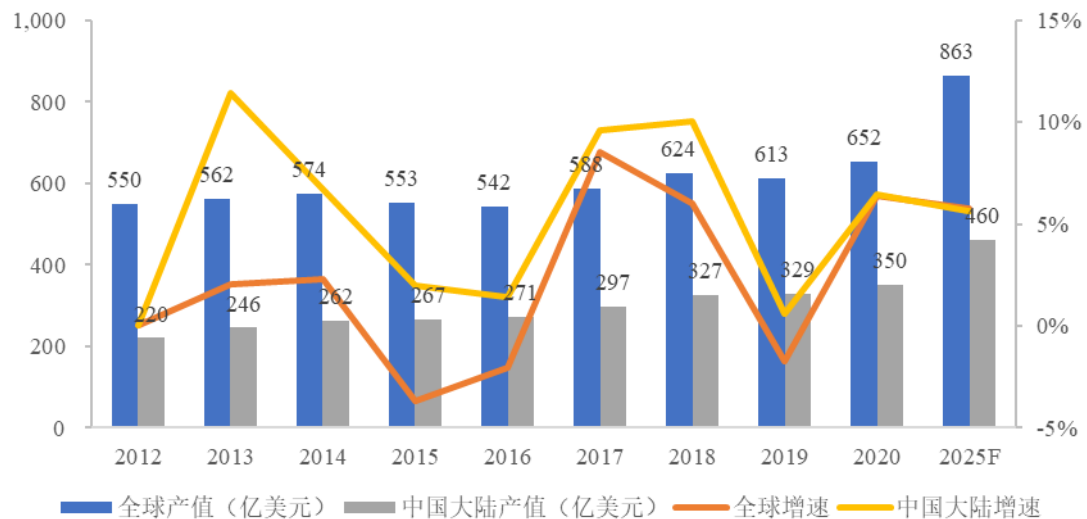
2010-2021 年全球电子信息产品产值



数据来源: JEITA

在当前云计算、5G、大数据、物联网、人工智能、工业 4.0 等应用场景的加速演变下, PCB 行业将迎来广阔的市场空间和良好的发展前景。根据 PrismaMark 数据, 2020 年全球 PCB 产业产值为 652.19 亿美元, 同比增长 6.37%; 2020 至 2025 年预计将以 5.77% 的年均复合增长率增长, 到 2025 年全球 PCB 行业产值将达到 863.25 亿美元, 中国大陆 PCB 产值将持续占据全球 50% 以上市场份额。

2012-2025 年 PCB 产值及增长情况预计



数据来源: PrismaMark

2、产业政策大力支持 PCB 产业发展

PCB 作为电子信息产业的基础产品, 在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。近年来, 我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策, 以

推进 PCB 行业的战略调整与产业升级，为国内 PCB 企业提供了良好发展契机。

其中，对 PCB 行业发展影响较大的法律法规、产业政策具体如下：

时间	部门	政策名称	有关内容
2021年1月	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	提出到2023年电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，重点发展产品包括高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板等。
2020年5月	国务院	《2020年国务院政府工作报告》	提出加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	将半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料列为鼓励性产业目录。
2019年1月	工信部	《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》	加强印制电路板行业管理，提高行业发展水平，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。
2017年6月	国家发改委、商务部	《外商投资产业指导目录》（2017）	将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板”列入鼓励外商投资产业目录。
2017年1月	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》	将“高密度互联印刷电路板、柔性多层印刷电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。
2016年9月	国家发改委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》	将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造（C27）列为鼓励发展的重点行业。
2016年2月	科技部、商务部	《国家重点支持的高新技术领域》	将中高档机电组件：超小型、高可靠、高密度的高速连接器制造技术；新型高可靠通信继电器制造技术；小型化组合式大电流继电器制造技术；高可靠固体光/MOS继电器制造技术；高保真、高灵敏、低功耗电声器件制造技术；刚挠结合板和HDI高密度积层板技术等列入国家重点支持的高新技术领域。
2013年3月	广东省人民政府办公厅	《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》	4. 提升基础产品。（1）……，重点发展微小型表面贴装元器件、高端印制电路板及覆铜板、新型绿色电池、新

时间	部门	政策名称	有关内容
			型半导体分立器件.....
2012年2月	国家工业和信息化部	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	加快发展高密度互连板、特种印制板、发光二极管(LED)用印制板及现代光学所需的红外焦平面探测器、紫外探测器、微光像增强器等关键核心器件。
2011年4月	国家发改委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录(2011年版)》	确定新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印制电路板和柔性电路板等)制造为鼓励进口的技术和产品。
2009年4月	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子器件产业体系。

3、高多层板、HDI板等未来应用需求增加，市场需求旺盛

通信是PCB最主要的下游应用领域，通信领域的PCB需求分为通信设备和移动终端，通信设备的PCB需求以多层板为主，移动终端的PCB需求以HDI板、挠性板和封装基板为主，5G时代的到来激发了通信设备和移动终端等市场的巨大需求。

一方面，5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，商用步伐不断加快，2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家运营商发放5G商用牌照，我国5G商用迈出了关键一步。根据工信部数据，截至2021年11月，我国5G基站超139.6万个，5G手机终端连接数达4.97亿户，未来几年，5G基站建设数量将大幅增长。随着5G技术的应用和不断推进，通信行业将迎来新一轮的更新换代建设，为PCB市场尤其是高多层板带来新的市场机遇。根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，预计2020年5G将带动约4,840亿元直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。

另一方面，新冠疫情促使全社会数字化进程向各个领域加速渗透，远程工作、居家学习等成为新生活常态，智能手机等移动终端市场需求旺盛，5G正式商用带来的换机潮亦推动智能手机需求增长。同时，指纹识别、3D Touch、全面屏、

双摄、人脸识别、折叠屏等智能手机创新点不断涌现，各大手机品牌商通过不断创新、丰富产品功能、优化使用体验激发消费者换机需求。随着智能手机功能集成需求越来越大，功能模块越来越多，单机所需 PCB 尤其是高端 PCB 的价值越来越高，未来移动终端领域的 PCB 产品需求仍将是 PCB 行业增长的主要驱动力之一，HDI 板未来增长空间广阔。

（二）本次非公开发行的目的

1、扩大产能，提升产品竞争力

由于国内 PCB 板生产企业中大部分企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，因此高端产品产能增长有限。但随着下游行业的快速发展，高端 PCB 板的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数具有技术领先优势的企业，已具有能够规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力，主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等。但由于受到场地及产能的限制，公司高端 PCB 板的产能已不能满足高端市场快速发展的需求，因此，公司亟需进一步扩大高端产品的产能，提升产品竞争力。本次募集资金到位后，公司将扩大高多层板、HDI 板的产能，改善产品结构，提升产品市场竞争力。

2、巩固行业领先地位，增强公司市场竞争力

公司专注于 PCB 的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，也已发展成为国内领先的 PCB 板生产企业，形成了明显的竞争优势，并具备了参与全球竞争的实力。根据 Prismark 的数据，公司 2020 年在全球 PCB 百强企业排名第 31 位。根据 CPCA 的数据，公司 2020 年在中国电路板百强企业排名第 16 位，内资企业排名第 5 位。

通过本次非公开发行股票可进一步提高公司资本实力，同时通过珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）的建设，可进一步提升公司市场份额，巩固行业领先地位，增强公司产品国际竞争力，为公司实现成为世界一流电子电路制造企业的目标奠定坚实的基础。

三、本次发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期限内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根

据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2021 年 9 月 30 日的总股本 875,638,601 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 262,691,580 股（含本数）。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象

所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（七）募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	365,065.83	200,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（八）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次非公开发行前的滚存利润分配安排

公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

（十）本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十一）关于本次发行方案的调整

如本次发行前，相关上市公司再融资法规被修订并实施的，公司将及时履行相关审议程序，按照调整后的相关政策对本次非公开发行股票方案进行调整。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司本次非公开发行尚无确定的发行对象，最终是否存

在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公司公告的发行情况报告书等文件中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本为 875,638,601 股，控股股东姜雪飞持有公司 56.85% 的股权；实际控制人姜雪飞和朱雪花（配偶关系）合计持有公司 63.16% 的股权。

本次非公开发行股票的数量不超过 262,691,580 股（含本数），按发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的 875,638,601 股增加到 1,138,330,181 股，姜雪飞持股比例预计不低于 43.73%，姜雪飞和朱雪花持股比例预计不低于 48.59%，姜雪飞仍为公司控股股东，姜雪飞和朱雪花仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次非公开发行不构成重大资产重组。本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次非公开发行有关事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	365,065.83	200,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析

（一）项目基本情况

珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目采用分期建设方式，本次募投项目“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）”为该项目的第二期建设。本项目拟新建印制电路板生产厂房及配套设施，以达到新增公司印制电路板产能的目的。项目建设期为 24 个月，拟由公司全资子公司珠海崇达实施，达产后将新增年产 108 万平方米高多层板和 42 万平方米 HDI 板的产能。项目实施地点为珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 999 号。

项目名称	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）
项目投资总额	365,065.83 万元
项目实施主体	珠海崇达电路技术有限公司
项目实施地点	珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 999 号
项目建设期	2 年

（二）项目建设的必要性

1、公司业务发展战略需要

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电

路板行业是电子信息产业中不可或缺的重要组成部分。在国家致力于实现国民经济和社会的信息化发展背景下，新一代移动通信技术对网络传输速率、时延和可靠性，以及设备连接密度、流量密度提出了更高的要求，未来通信基站、服务器及终端的海量需求为电子信息产业带来了难得的发展机遇，在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB产业有着广阔的市场空间和良好的发展前景。

受益于5G通信、汽车电子以及消费电子等下游应用领域的迅速发展，全球PCB行业稳步增长，且全球PCB产能向中国大陆转移，国内市场PCB需求增长较快，国内PCB企业迎来黄金发展阶段。随着下游客户需求逐渐增大，公司相关产品的产能会面临无法满足下游企业订单需求的风险。若没有足够的场地及相关设备用于产品的生产，公司一方面将面临大客户订单流失的风险，另一方面也会使公司失去进一步提升市场占有率的机会。因此，在保持公司现有生产的情况下，公司进一步积极扩大产能、完善和提高服务客户能力水平、增强公司核心竞争力。公司将深耕PCB行业，利用在通信、医疗仪器、工业控制、安防电子等PCB需求领域的既有优势，以成本领先和技术领先为前提，坚持以市场为导向，以客户为中心，力争在大客户、大批量的战略转型方面取得更大成绩，为成为世界一流电子电路制造企业不断提升自身的经营管理水平。

2、扩大产能，提升产品竞争力

由于国内PCB板生产企业中大部分企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，因此高端产品产能增长有限。但随着下游行业的快速发展，高端PCB板的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数具有技术领先优势的企业，已具有能够规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力，主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等。但由于受到场地及产能的限制，公司高端PCB板的产能已不能满足高端市场快速发展的需求，因此，公司亟需进一步扩大高端产品的产能，提升产品竞争力。本次募集资金到位后，公司将扩大高多层板、HDI板的产能，改善产品结构，提升产品市场竞争力。

3、巩固行业领先地位，增强公司市场竞争力

公司专注于PCB的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，

也已发展成为国内领先的 PCB 板生产企业，形成了明显的竞争优势，并具备了参与全球竞争的實力。根据 PrismaMark 的数据，公司 2020 年在全球 PCB 百强企业排名第 31 位。根据 CPCA 的数据，公司 2020 年在中国电路板百强企业排名第 16 位，内资企业排名第 5 位。

通过本次非公开发行股票可进一步提高公司資本实力，同时通过珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）的建设，可进一步提升公司市场份额，巩固行业领先地位，增强公司产品国际竞争力，为公司实现成为世界一流电子电路制造企业的目标奠定坚实的基础。

（三）项目建设的可行性

1、产业政策大力扶持，PCB 行业发展迅速

PCB 行业是电子信息产业中重要的组成部分，在国家产业政策和相关法律法规的支持和保障下，行业市场规模不断扩大，朝着高端化、集约化的方向持续发展。本项目产品属于《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化相关内容、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中电子核心产业指导目录内容和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类产业。而国家相关产业政策的逐步推出，为国内印制电路板行业高端化发展奠定了坚实的政策基础，产业政策大力扶持下，PCB 行业未来增长空间广阔。

2、公司拥有高素质员工团队和研发人员储备

截至 2021 年 9 月 30 日，公司共有员工 6,126 人，其中研发人员 919 人。通过不断的外部招聘和内部培养，公司形成了一支在 PCB 行业内就管理、研发、生产、销售各环节拥有专业水平和实践能力的高素质员工团队，能够为募投项目的顺利实施提供保障。

3、公司拥有丰富的产品技术储备及成熟的生产技艺

公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有专利数量 283 项，处于行业领先水平，其中发明专利 237 项、实用新型专利 46 项；拥有软件著作权 27 项；主导制定国家标准 4 项、地方标准 1

项、行业标准 4 项，参与开发 IPC 中文标准 3 项。同时，公司也积极开展新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新性研发机制。因此，公司技术储备实力雄厚，专利技术丰富，可确保公司针对行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，为项目的顺利实施提供重要保障。

4、公司拥有丰富的客户资源和强大的市场开发能力

公司深耕 PCB 行业二十余年，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。公司深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500 强及下游行业领先企业的合作，其中 5G 客户方面，公司合作的主要客户有中兴通讯、烽火通信、康普 (CommScope)、高意 (II-VI)、博通 (Broadcom)、安费诺 (Amphenol)、Intel 等。在 5G 通讯之外，公司合作的大客户还包括：ABB、施耐德 (Schneider)、博世 (Bosch)、海康威视、大华科技、京东方 (BOE)、新华三 (H3C)、松下 (panasonic)、Preh 均胜、捷温、雅达 (ASTEC)、伟创力 (Flextronics)、捷普 (Jabil) 等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富，公司的客户在各区域、行业分布均衡，有效分散了经营风险。因此，公司客户资源丰富，客户主要为全球知名企业，且新行业、新客户的开发能力较强。广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，保障募投项目的顺利实施。

综上所述，公司是国内 PCB 行业的领先者，拥有丰富的技术储备及成熟的生产技艺，广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以顺利保障募投项目的实施。

(四) 项目投资概算

本项目投资总额为 365,065.83 万元，其中建筑工程费 140,476.18 万元、设备购置费 185,063.30 万元、安装工程费 3,701.27 万元、工程建设其他费用 3,361.27 万元、预备费及铺底流动资金 32,463.81 万元。募集资金拟投入金额为 200,000.00 万元，全部用于本项目的资本性支出。

(五) 项目经济效益

本项目建设周期为 24 个月。经测算，预计项目内部收益率(税后)为 10.07%，静态投资回收期(税后)为 8.07 年，具有良好的经济效益。

（六）项目备案、环评及土地情况

1、发改委备案情况

本项目备案手续正在办理过程中。

2、环评情况

2018年3月29日，本项目在广东省环境保护厅完成了项目环境保护审批手续，并取得了《广东省环境保护厅关于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（年产电路板640万平方米）环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕89号）。

3、土地情况

本项目在公司现有工业用地上实施建设，建设地块位于珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道999号，并取得了编号为粤（2018）珠海市不动产权第0092913的不动产权证书。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于印制电路板生产线建设项目。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行将进一步扩大公司产能，提升产品竞争力，巩固公司在PCB行业的领先地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。尽管募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，但长期来看，公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施有所增加。本次募集资金投资项目有利于公司进一步扩大产能，完善和提高服务大客户能力水平，增强公司核心竞争力，具有良好经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。但同时，本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内可能对公司净资产收益率、每股收益产生一定的摊薄作用。

四、本次募集资金运用的可行性结论

综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合本公司及全体股东的利益。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，与公司现有业务保持一致，有利于进一步扩大公司产能，完善和提高服务客户能力水平，增强公司核心竞争力。

本次发行不涉及公司业务与资产的整合。本次发行后，公司总资产规模、净资产规模均将有所提高，公司主营业务范围保持不变。

（二）本次发行对《公司章程》的影响

本次发行完成后，公司将对《公司章程》中关于公司注册资本、股本等与本次非公开发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无就此次发行对《公司章程》其他条款修订的计划。

（三）本次发行对股东结构的影响

截至2021年9月30日，公司总股本为875,638,601股，控股股东姜雪飞持有公司56.85%的股权；实际控制人姜雪飞和朱雪花（配偶关系）合计持有公司63.16%的股权。

本次非公开发行股票的数量不超过262,691,580股（含本数），按发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的875,638,601股增加到1,138,330,181股，姜雪飞持股比例预计不低于43.73%，姜雪飞和朱雪花持股比例预计不低于48.59%，姜雪飞仍为公司控股股东，姜雪飞和朱雪花仍为公司实际控制人。因此本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级管理人员结构进行调整，将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司将进一步扩大现有业务产能，完善和提高服务客户能力水平，增强公司核心竞争力。公司的主营业务和总体业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。

二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，公司的资金实力将得到提升，公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司财务结构、降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定基础。

（二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的资金实力得到加强，将满足公司主营业务的发展空间，保障长期发展的资金需求，有利于公司盈利能力和整体竞争实力的提升。

（三）对公司现金流的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将显著增加。在本次募集资金投资项目开始建设投入后，公司的投资活动现金流出额将相应增加。随着募集资金投资项目投产和产生效益，公司的经营活动现金流入将随着公司收入和利润的增长而相应增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，姜雪飞仍为公司控股股东，姜雪飞和朱雪花仍为公司实际控制人，公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，不会因本次发行新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。

公司的董事会、监事会以及管理层仍将依法合规运作，公司仍将保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性，本次发行对公司治理不

存在实质性影响。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规、公司章程及公司相关制度的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的偿债能力和抗风险能力将得到有效提升。

六、本次发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

（一）宏观经济波动风险

PCB 行业作为电子信息产业的基础行业，受宏观经济及下游行业的周期性波动影响较大。据 PrismaMark 统计，受贸易战、英国脱欧等地缘政治因素影响，2019 年全球 PCB 市场规模同比小幅下降 1.74%，而在 5G 基础设施建设、大数据、人工智能以及智慧城市等信息化加速的大环境下，2020 年全球 PCB 市场规模同比增长 6.37%；同时，PrismaMark 预测，2020 至 2025 年全球 PCB 行业将以 5.77% 的年均复合增速增长，2025 年全球 PCB 市场规模将达到 863.25 亿美元。尽管行业发展趋势整体向好，但是受宏观经济影响和风险事件造成的不确定性仍然需要关注。

公司主要产品的下游行业分布广泛，呈现客户数量多、客户和订单较为分散的特点，因此在一定程度上分散了宏观经济对公司的影响。但是，若未来经济景

气度低迷甚至下滑，仍有可能引致下游行业需求萎缩从而使公司面临盈利能力降低的风险。

（二）市场竞争加剧风险

PCB 行业市场竞争充分，各类规模的生产企业众多，未出现市场主导者，市场集中度较低。据 PrismaMark 统计，2020 年全球产值最大的 PCB 制造商臻鼎科技的产值占比仅为 6.81%。目前，全球约有近 3,000 家 PCB 生产企业，主要分布在美国、日本、欧洲、韩国、中国大陆及中国台湾，行业竞争比较激烈。

经过多年的发展，公司积累了丰富的管理经验和客户资源，具有明显的先发优势，但受人力成本过高等因素影响，国外印制电路板生产厂商仍保持向中国大陆转移的趋势，未来印制电路板市场竞争可能加剧，如若生产管理、技术水平以及产品质量不能持续提升，公司的经营业绩将受到不利影响。

（三）贸易摩擦风险

报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入的比重超过 60%，公司出口产品主要销往亚洲、欧洲、美国等国家或地区，2018 年以来美国多次宣布对我国商品加征进口关税。虽然公司直接对美国出口收入金额较低，呈下降趋势；且中美两国政府一直保持谈判磋商，一定程度上缓解了贸易摩擦的影响，但如果未来中美贸易争端升级、加征关税税率提高，或与其他国家发生贸易摩擦，将增加宏观经济环境的复杂性和不确定性，损害国际贸易正常经济秩序，公司将面临外销客户采购公司产品含关税的购买价格进一步上涨、毛利下降的风险，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。

（四）原材料价格波动风险

公司原材料成本占主营业务成本的比重较高，约为 70%左右；其中，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾，受贵金属铜、黄金和石油的价格影响较大。受新冠疫情、宏观经济环境及部分供应链突发事件等多重因素影响，2020 年下半年以来，公司主要原材料价格呈上涨趋势。若原材料价格大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵销原材料成本上涨的压力，又或在价格下降时未能做好存货管理，都将会对

公司的经营业绩产生不利影响。

（五）汇率波动风险

公司产品以外销为主，报告期内公司产品境外销售收入占主营业务收入的比重超过 60%，汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响。若未来人民币升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，同时对境外销售收入将产生汇兑损失，对公司经营业绩造成不利影响。

（六）出口退税政策变化风险

公司印制电路板产品的出口享受免、抵、退的增值税政策。报告期内，公司的出口退税率为 17%、16% 或 13%。若未来国家出口退税的相关政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但是未来不排除受资金筹措、材料及设备供应延迟，市场需求变动或者宏观经济形势变化等因素的影响，募投项目建设进度可能延迟，进而影响项目的投资回报及公司的预期收益。

2、固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，在项目建设达到预定可使用状态后，公司将新增较大金额的固定资产折旧。尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证，但如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、新增产能无法及时消化的风险

近年来，在智能制造及绿色制造浪潮的推动下，印制电路板行业市场份额逐步向龙头企业集中，同行业上市公司积极从事固定资产投资，提升产能，以积累竞争优势、扩大经营规模、筑高行业门槛。本次募集资金投资项目实施完毕后，公司的产能将得到一定幅度提升，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场

开拓滞后或市场环境发生重大不利变化,公司将存在无法及时消化新增产能的风险,进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

4、即期回报摊薄风险

本次募集资金到位后,公司总股本和净资产将会相应增加,而募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,在总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

(八) 管理风险

公司通过长期的实践积累,虽然已具备符合公司现有生产系统的管理技术和能力,能够满足客户纷繁多样的需求,并作出及时、快速响应,但随着公司生产规模的不断扩大、生产技术的提高、工艺流程的日趋复杂,如果公司未来不能在管理方式上及时创新,以适应公司规模快速扩张的需要,可能导致交货期延长、竞争力削弱、客户流失等。

(九) 其他风险

1、审批风险

本次非公开发行股票相关事宜尚需获得公司股东大会审议批准,并报中国证监会核准。能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

2、募集资金不足或发行失败的风险

公司本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,董事会审议通过本次发行方案时尚未确定发行对象。本次发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案认可程度以及市场资金面情况等多种因素的影响,因此本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险。

3、股票市场波动风险

股票投资本身具有一定的风险。股票价格不仅受公司的财务状况、经营业绩和发展前景的影响,而且受到国家经济政策、经济周期、通货膨胀、股票市场供求状况、重大自然灾害发生等多种因素的影响。因此本次发行完成后,公司二级市场股价存在不确定性,若股价表现低于预期,则存在导致投资者遭受投资损失

的风险。

4、不可抗力风险

自然灾害、战争、重大公共卫生或重大疾病以及其他突发性事件可能会对募集资金投资项目、上市公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次非公开发行股票的进程及上市公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能会给上市公司增加额外成本，从而影响上市公司的盈利水平。

5、新冠疫情引致的经营风险

2020年初以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，全球大多数国家和地区的生产生活遭受了不同程度的影响。尽管国内疫情已基本得到控制，国民经济各行业各部门也逐步恢复正常生产经营，但境外疫情仍较为严峻。未来如果国内疫情发生不利变化或国外疫情持续蔓延并传导至相关产业，则可能对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

第四节 公司利润分配政策的制定、执行情况 及未来股东回报规划

一、公司的利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定和要求，公司《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- 3、同股同权、同股同利的原则；
- 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（四）利润分配形式的优先顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（五）利润分配的条件

1、现金分红的比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

2、发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

3、全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

（六）利润分配应履行的审议程序

1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经

全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

（七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（八）利润分配政策调整

1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

(1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

(3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

(4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一) 最近三年利润分配情况

最近三年，公司利润分配方案和实施情况如下：

年度	利润分配方案	股权登记日	除权除息日
2020年度	以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.50元（含税），不转增股本，不送红股。	2021-05-19	2021-05-20
2019年度	以公司总股本884,026,738股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不转增股本，不送红股。	2020-06-02	2020-06-03
2018年度	以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派3.4元人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。	2019-04-22	2019-04-23

(二) 最近三年现金分红情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	44,061.92	52,604.88	56,056.96
现金分红金额（含税）	22,063.72	26,520.80	28,332.15
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	50.07%	50.42%	50.54%
最近三年累计现金分红合计	76,916.68		
最近三年实现的年均可分配利润	50,907.92		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	151.09%		

（三）最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出，继续投入公司生产经营。

三、公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划

为完善和健全公司持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《崇达技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- 3、同股同权、同股同利的原则；
- 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（四）利润分配形式的优先顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（五）利润分配的条件

1、现金分红的比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

2、发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

3、全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

(六) 利润分配应履行的审议程序

1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

(七) 董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安

排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（八）利润分配政策调整

1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

（九）本规划的生效与解释等事项

1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定

执行。

2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体情况如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设

以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，不构成公司盈利预测，亦不构成对本次发行实际完成时间的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

- 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
- 2、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
- 3、假设本次非公开发行方案于2022年9月实施完成（上述假设不构成对本次发行实际完成时间的判断，仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响），最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准。
- 4、截至2021年9月30日，公司总股本为875,638,601股，假设本次非公开发行数量为262,691,580股（不超过本次发行前上市公司总股本的30%），本次非公开发行募集资金总额为200,000.00万元（不考虑发行费用的影响）。本次非公开发行数量以及实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
- 5、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为45,797.64万元，较2020年同期增长22.07%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为43,211.62万元，较2020年同期增长25.73%。基于上述增长情况，假设2021年

度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别较 2020 年度增长 20%，测算 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 52,874.30 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 47,098.05 万元（上述假设不构成盈利预测）。

假设公司 2022 年度扣除非经常性损益前后净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与 2021 年度持平；（2）较 2021 年度减少 20%；（3）较 2021 年度增长 20%（上述假设不构成盈利预测）。

6、在测算公司净资产及加权平均净资产收益率时，未考虑除本次非公开发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7、在测算本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他股份变动事宜。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，不构成公司盈利预测，亦不构成对本次发行实际完成时间的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）测算结果

基于上述假设情况，在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2021-12-31 /2021 年度	2022-12-31/2022 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	87,563.86	87,563.86	113,833.02
假设 2022 年度扣除非经常性损益前后净利润与 2021 年度持平			
归属于上市公司股东的净资产（万元）	451,860.66	504,734.96	704,734.96
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,874.30	52,874.30	52,874.30
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,098.05	47,098.05	47,098.05
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.56
扣非后基本每股收益（元/股）	0.54	0.54	0.50
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.54	0.54	0.50
加权平均净资产收益率	12.20%	11.05%	10.01%

项目	2021-12-31 /2021年度	2022-12-31/2022年度	
		本次发行前	本次发行后
扣非后加权平均净资产收益率	10.87%	9.85%	8.92%
假设 2022 年度扣除非经常性损益前后净利润较 2021 年度减少 20%			
归属于上市公司股东的净资产（万元）	451,860.66	494,160.10	694,160.10
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,874.30	42,299.44	42,299.44
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,098.05	37,678.44	37,678.44
基本每股收益（元/股）	0.60	0.48	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.48	0.45
扣非后基本每股收益（元/股）	0.54	0.43	0.40
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.54	0.43	0.40
加权平均净资产收益率	12.20%	8.94%	8.09%
扣非后加权平均净资产收益率	10.87%	7.97%	7.20%
假设 2022 年度扣除非经常性损益前后净利润较 2021 年度增长 20%			
归属于上市公司股东的净资产（万元）	451,860.66	515,309.82	715,309.82
归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,874.30	63,449.16	63,449.16
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,098.05	56,517.66	56,517.66
基本每股收益（元/股）	0.60	0.72	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.72	0.67
扣非后基本每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.60
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.60
加权平均净资产收益率	12.20%	13.12%	11.89%
扣非后加权平均净资产收益率	10.87%	11.69%	10.59%

经测算，本次非公开发行完成后，短期内公司每股收益、加权平均净资产收益率将可能出现一定程度的下降，本次募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将会相应增加，而募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标短期可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存

在被摊薄的风险。特别提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	365,065.83	200,000.00

本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

关于本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析，请见本预案之“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投资于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）。珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）的建设将进一步扩大公司产能，提升产品竞争力，巩固公司在 PCB 行业的领先地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

因此，本次募投项目与公司现有业务紧密相关，通过上述募投项目，将进一步提升公司影响力和市场价值，全方面实现公司健康、均衡、持续的发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、公司拥有高素质员工团队和研发人员储备

截至 2021 年 9 月 30 日，公司共有员工 6,126 人，其中研发人员 919 人。通过不断的外部招聘和内部培养，公司形成了一支在 PCB 行业内就管理、研发、生产、销售等各环节拥有专业水平和实践能力的高素质员工团队，能够为募投项

目的顺利实施提供保障。

2、公司拥有丰富的产品技术储备及成熟的生产技艺

公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有专利数量 283 项，处于行业领先水平，其中发明专利 237 项、实用新型专利 46 项；拥有软件著作权 27 项；主导制定国家标准 4 项、地方标准 1 项、行业标准 4 项，参与开发 IPC 中文标准 3 项。同时，公司也积极开展新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新性研发机制。因此，公司技术储备实力雄厚，专利技术丰富，可确保公司针对行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，为项目的顺利实施提供重要保障。

3、公司拥有丰富的客户资源和强大的市场开发能力

公司深耕 PCB 行业二十余年，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。公司深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500 强及下游行业领先企业的合作，其中 5G 客户方面，公司合作的主要客户有中兴通讯、烽火通信、康普 (CommScope)、高意 (II-VI)、博通 (Broadcom)、安费诺 (Amphenol)、Intel 等。在 5G 通讯之外，公司合作的大客户还包括：ABB、施耐德 (Schneider)、博世 (Bosch)、海康威视、大华科技、京东方 (BOE)、新华三 (H3C)、松下 (panasonic)、Preh 均胜、捷温、雅达 (ASTECC)、伟创力 (Flextronics)、捷普 (Jabil) 等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富，公司的客户在各区域、行业分布均衡，有效分散了经营风险。因此，公司客户资源丰富，客户主要为全球知名企业，且新行业、新客户的开发能力较强。广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，保障募投项目的顺利实施。

五、公司填补本次非公开发行即期回报摊薄的具体措施

公司拟通过加大现有业务拓展力度、提高运营效率、加强募集资金管理、保障募投项目投资进度等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补本次非公开发行摊薄即期回报的影响。

（一）加大现有业务拓展力度

公司是国内 PCB 行业的领先者，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力。在保持海外市场优势的基础上，近几年来公司不断加大国内市场的开拓力度，积极建设国内销售团队和营销服务网络，深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500 强及下游行业领先企业的合作。随着国内通信设备、工业控制、汽车电子、医疗仪器、安防电子等下游行业的迅猛发展，公司专业、专注的竞争优势将在未来得到充分体现。

公司主要产品的下游行业分布广泛，呈现客户数量多、客户和订单较为分散的特点。未来公司将在现有客户资源基础之上，提升产品质量，不断开发新客户、不断增加老客户的采购比例，优化产品结构，提升高多层板、高频高速板、HDI 板、IC 载板等高端产品的收入金额及占比，进一步拓展中大批量订单占比，带动公司整体收入规模持续增加，从而增强公司盈利能力和盈利质量。公司将通过上述措施进一步提升公司经营业绩，有效防范本次发行对投资者回报摊薄的风险。

（二）提高运营效率，提升公司业绩

公司通过与 ORACLE、IBM 等合作建设了高效的 ERP 系统，公司的 IT 系统、生产系统拥有对客户纷繁多样的需求作出及时、快速反应的管理技术和能力，例如利用先进的 IT 系统，结合条码管理技术，通过制定生产 WIP 表（生产流程排计划表）和 LOT 卡（产品生产批量管制卡），可以安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产等。

本次募投项目的实施可以进一步提高公司生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提升公司业绩，有效防范本次发行对投资者回报摊薄的风险。

（三）加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按计划合理合法使用。

（四）保障募投项目投资进度，进一步提升生产能力和公司效益

公司董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证，通过本次发行募集资金投资项目的实施将进一步扩大公司产能，提升产品竞争力，巩固公司在 PCB 板行业的市场地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力，更好地回报投资者。

（五）强化投资者回报机制

为完善和健全公司分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等相关规范文件精神，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了投资者回报机制。本次非公开发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

综上所述，通过本次非公开发行股票，公司将进一步增强核心竞争力和可持续经营能力，并将尽快产生效益回报股东。上述制定的填补即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

（一）控股股东、实际控制人的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东姜雪飞、实际控制人姜雪飞和朱雪花夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。

（二）公司董事和高级管理人员的承诺

鉴于崇达技术拟非公开发行股票，崇达技术预计本次非公开发行完成后，当年每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标有可能低于上年度，导致崇达技术即期回报被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、即期回报摊薄的填补措施以及相关承诺主体的承诺等相关事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日